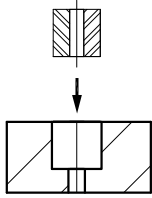
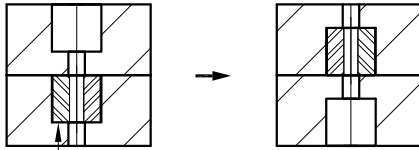


■조립방법 (JIG : DEQ01173-N/1 사용)

<STEP 1> 절연체 삽입

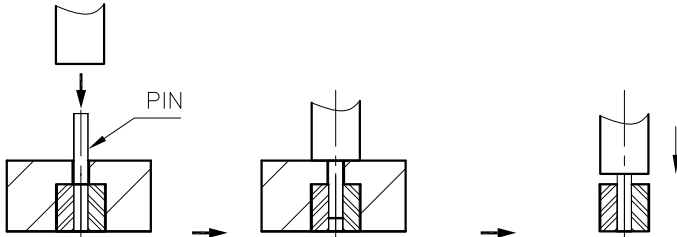


<STEP 2> JIG 2EA 체결 후 뒤집기 (접시머리 M2.3 5mm)



TEFLON

<STEP 3> 핀셋 이용하여 핀 삽입 후 가조립 (핀+절연체 가조립 시 지그 손으로 누름)
가조립 완료 후 그림과 같이 지그면 끝까지 누를것

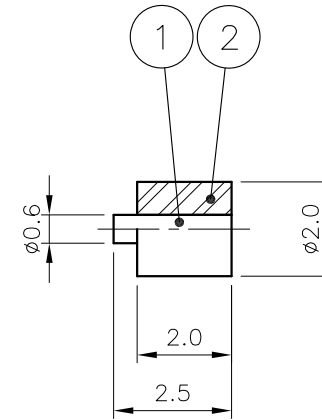


★ 조립 후 검사 주의사항

- PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2024.01.02.



2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/4
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/A
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2024. 01. 02.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle ±1°	APPROVED BY				
MATERIAL _____	CHECKED BY			TITLE BUSHING		
	DRAWN BY S.H.KIM					
FINISH _____	SCALE 6/1	UNIT mm			A4	DWG NO. CN03890-7/E
						REVISION I R